

K-No.: 24063

Signal Transformer

Date: 24.04.2015

Customer: Standard type

Customers part No.:

Page 1 of 3

Mechanical outline (mm): (General Tolerances DIN ISO 2768-c)

Toleranz der Stiftabstände
±0,2 mm
(Tolerances grid distance)

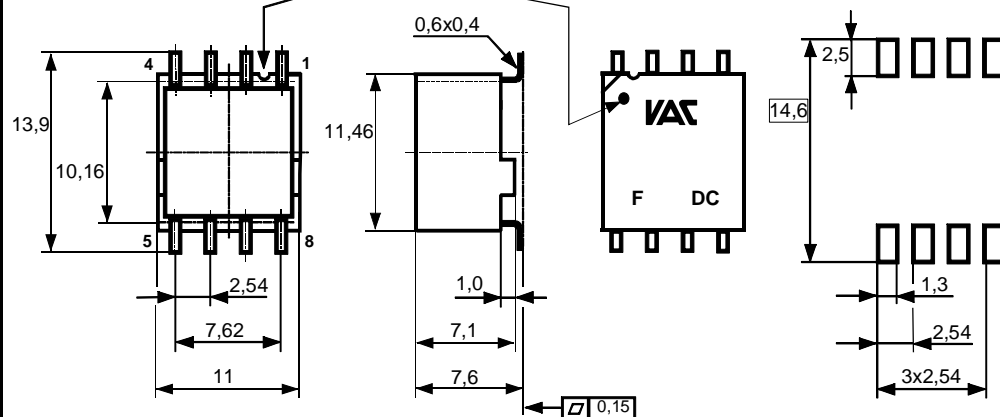
Kennzeichnung Stift 1
(marking pin 1)

DC=Date Code
F=Factory

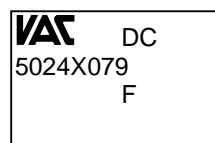
Vorschlag zur Anordnung
der Anschlußflächen
(Example for pad position)

Connections:

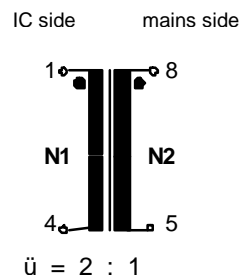
Unused pin(s):
No. 3,2,6,7



Beschriftung:
marking



Schematic diagram:



Operational data/characteristic data (nominal values):

f = 10 kHz...1 MHz

LS₁₋₂ ≤ 2 µH;

C_{K1-2} ≤ 50 pF

R_{Cu1} ≤ 350 mΩ, R_{Cu2} ≤ 120 mΩ

Operating temperature: -40 °C ... +120 °C

Storage temperature: -40 °C ... +85 °C

Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

- | | | | | |
|----|------------|----------|--|------------------------------|
| 1) | (V) | M3014: | U _{p,eff} = 3,0 kV, 2 s, | N1 to N2 |
| 2) | (AQL 0,25) | M3011/1: | L ₂ = 1,40 mH* ± 30%, f = 10 kHz, | U _{AC,eff} = 100 mV |
| 3) | (V) | M3011/6: | Polarity, Turns ratio: | Tolerance ± 2 % |
| 4) | (Fix05) | M3291: | Solderability test acc. 1 | |
| 5) | (AQL 1/S4) | M3200: | Mechanical test | |

see page 2

Applicable documents: See page 2

Date	Name	Index	Change
24.04.15	Bs.	83	Typo: storage temperature changed from +120°C → +85°C. lapidary change.

Editor: KB-E	Design: Bs.	KB-PM: Ert. check	released: HH
--------------	-------------	----------------------	--------------

K-No.: 24063

Signal Transformer

Date: 24.04.2015

Customer: Standard type

Customers part No.:

Page 2 of 3

Type test

1) M3292: Resistance to soldering heat acc. to chapter 2

2) High voltage test according to M3014

$U_{p,eff} = 3 \text{ kV}$, 1 min, N1 vs N2

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

*preliminary

Applicable documents:

Designed, manufactured and tested in accordance to EN 60950 and complies with the standards.

Parameters: Reinforced insulation: N1-N2

Working voltage: 400 V r.m.s.

overvoltage category: 2

Pollution degree: 2

Insulation material group: 3

Housing material, casting resin and wire UL – listed

Packing: Drypack / MSL according VAC M3027

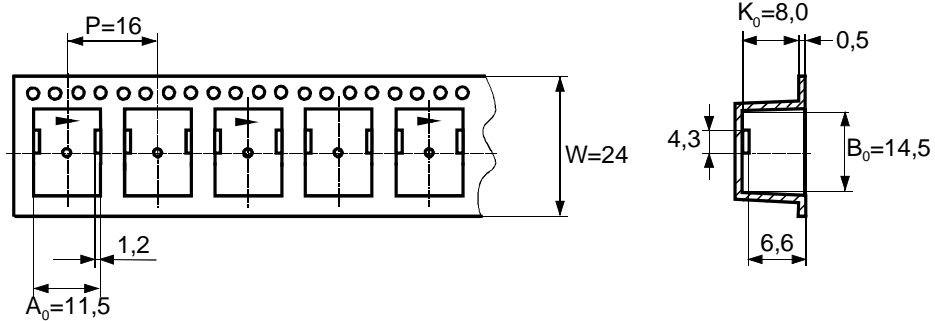
Editor: KB-E

Design: Bs.

KB-PM: Ert.
check

released: HH

packing information / Verpackungsinformation



the first two nests must be crushed for better pockets.
Die ersten zwei Nester gequetscht für besseres einfädeln.

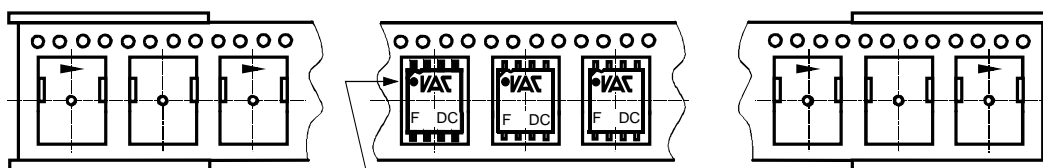
leading 25 empty pockets
Vorlauf 25 leere Nester

laging 25 empty pockets
Nachlauf 25 leere Nester

cover tape 400mm longer than carrier tape
Deckband 400mm länger als Blistergurt

laging:>25 empty pockets
Nachlauf >25 leere Nester

leading:>25 empty pockets
Vorlauf >25 leere Nester



Orientation of Pin 1 in carrier tape
Anordnung von Stift 1 im Blistergurt

Insertion of components according orientation 3 shown in M-sheet 3510
Einsetzen der Bauelemente nach M-Blatt 3510 Orientierung 3

quantities in packing: 450 pieces/tape (packing carton) 450 Bauelemente/Rolle
Verpackungsmenge 5 tapes reel/carton (outside)=2250 pieces /carton(outside)
5 Rollen/Karton =2250 Bauelemente /Außenkarton

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9